(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年3月7日(07.03.2024)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2024/048366 A1

(51) 国際特許分類:
H05H 1/46 (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2023/030155

(22) 国際出願日： 2023年8月22日(22.08.2023)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
63/403,119 2022年9月1日(01.09.2022) US

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目３番１号 Tokyo (JP).

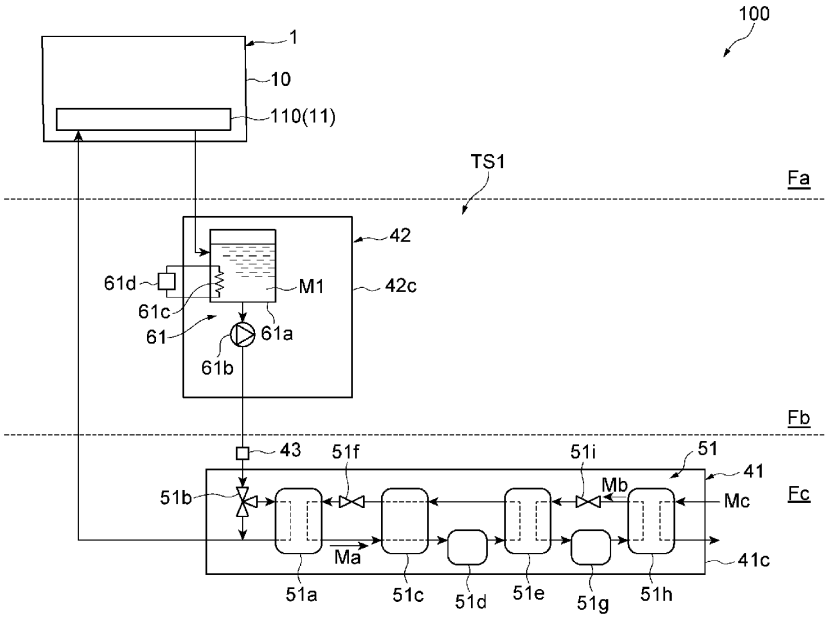
(72) 発明者: 坂井 隼人(**SAKAI Hayato**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 千葉 一弘(**CHIBA Kazuhiro**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ１番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).

(74) 代理人: 長谷川 芳樹，外(**HASEGAWA Yoshiki** et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号丸の内 ＭＹ ＰＬＡＺＡ（明治安田生命ビル） ９階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,

(54) **Title:** TEMPERATURE ADJUSTMENT SYSTEM AND PLASMA PROCESSING SYSTEM

(54) 発明の名称： 温調システム及びプラズマ処理システム



(57) **Abstract:** Disclosed is a temperature adjustment system which comprises a first segment, a second segment, and a connection unit. The first segment includes: a first temperature adjustment circuit including a first heat exchanger configured to perform heat exchange with a first temperature adjustment medium; and a first case for accommodating therein the first temperature adjustment circuit. The second segment includes: a first tank and a first pump in a first circulation system configured to circulate the first temperature adjustment medium through a first flow path in a first member of a

WO 2024/048366 A1

［続葉有］

CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国（表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能）：ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一　国際調査報告（条約第21条(3)）

plasma processing device; and a second case for accommodating therein the first tank and the first pump. The connection unit constitutes a part of the first circulation system, is disposed between the first segment and the second segment, and is connected between the first pump and the first heat exchanger.

(57) 要約：開示される温調システムは、第１のセグメント、第２のセグメント、及び接続部を備える。第１のセグメントは、第１の温調媒体との熱交換を行うように構成された第１の熱交換器を含む第１の温調回路及び第１の温調回路をその中に収容する第１のケースを含む。第２のセグメントは、プラズマ処理装置の第１の部材内の第１の流路に第１の温調媒体を循環させるように構成された第１の循環系における第１のタンク及び第１のポンプ、並びに第１のタンク及び第１のポンプをその中に収容する第２のケースを含む。接続部は、第１の循環系の一部であり、第１のセグメントと第２のセグメントとの間に配置され、第１のポンプと第１の熱交換器との間で接続される。